

101 年專門職業及技術人員高等考試驗船師、第 1 次食品技師
考試、高等暨普通考試消防設備人員考試、普通考試地政士、
專責報關人員、保險代理人保險經紀人及保險公證人考試、
特種考試語言治療師、聽力師、牙體技術人員考試試題

代號：5401
頁次：8-1

等 別：相當專技高考

類 科：牙體技術師

科 目：牙體技術學(三) (包括全口活動義齒技術學、活動局部義齒技術學科目)

考試時間：1 小時

座號：_____

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(二)本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。

(三)禁止使用電子計算器。

- 1 以下何者不是全口義齒金屬基底的優點？
(A)發音障礙較少 (B)異物感較小 (C)較衛生 (D)隔熱好
- 2 鎳鉻 (Ni-Cr) 合金的金屬床材質，包含 0.5% 鈹 (beryllium)，其主要功用為：
(A)增加硬度 (hardness) 及強度 (strength) (B)降低熔點，增加合金的流動性
(C)增加抗腐蝕性 (corrosion) (D)容易形成中間複合物 (intermediate compound)
- 3 使用金屬床的優缺點，下列何者錯誤？
(A)較高的技工費
(B)不易換底
(C)後腭封 (posterior palatal seal) 處鑄造精確，沒有異物感
(D)強度夠得以抵抗咬合力
- 4 鈦 (Ti) 金屬床鑄造困難的原因，下列何者錯誤？
(A)低密度 (B)高熔點
(C)化學上易與空氣作用 (D)不與包埋材中之成分起反應
- 5 當使用者配戴全口義齒進行咀嚼時，義齒發生動搖甚至脫離，係指該義齒的何項品質不好？
(A)固持性 (retention) (B)穩定性 (stability) (C)支持性 (support) (D)咀嚼能力
- 6 關於義齒人工牙齒破損與修理的描述，下列何者錯誤？
(A)咬合不協調是造成義齒人工牙齒破損的原因之一
(B)樹脂牙與基底接觸面需透過表面處理來達到與義齒基底間的接著力
(C)陶瓷人工牙較樹脂牙不易脫落
(D)多顆牙脫離或破損的修復時，有時需要對咬牙
- 7 關於義齒換基底 (rebase) 與襯底墊 (reline) 的敘述，下列何者錯誤？
(A)若義齒原有的咬合關係不佳，不適合進行換基底或襯底墊
(B)襯底墊容易造成上顎義齒腭部變厚
(C)義齒換基底時，使用陶瓷人工牙的義齒會較使用樹脂牙的義齒更不方便進行
(D)換基底無法以直接法在口內完成
- 8 有關義齒破損的描述，下列何者錯誤？
(A)因義齒設計錯誤造成的破損多在早期發生
(B)因牙技作業不完備造成的破損多在晚期發生
(C)因病患口內變化造成的破損多在晚期發生
(D)患者不當的使用也可能造成破損

- 9 有關義齒煮聚後造成咬合的變化，下列可能因素中何者錯誤？
(A)樹脂從可塑性到固體時造成的膨脹 (B)樹脂有高膨脹係數
(C)樹脂當冷卻時有聚合收縮 (D)義齒基底材料無法避免的誤差
- 10 新的義齒第一次裝戴於口腔內時，咬合的誤差較不可能來自下列何者？
(A)義齒與石膏模型分開時 (B)義齒磨光時產生太多熱
(C)患者肌肉萎縮 (D)壓克力樹脂吸收水分，造成膨脹
- 11 關於 BULL 法則的敘述，下列何者錯誤？
(A)使用在離中心咬合位的選擇修磨 (B)可以維持咬合高度
(C)BULL 代表不能修磨的部位 (D)主要在去除咬合干擾
- 12 關於義齒基底研磨的敘述，下列何者錯誤？
(A)基底邊緣的研磨應儘量薄以避免造成嘴唇的隆起
(B)臼齒後墊部位後緣需具一定的厚度
(C)義齒基底黏膜面若需要的話，只作輕微研磨即可
(D)小心不要磨損齒肉形成的型態
- 13 有關義齒基底床研磨的敘述，下列何者錯誤？
(A)粗研磨可使用鎢鋼鑽針 (B)中研磨可用砂紙捲磨錐
(C)完成研磨需使用濕潤的研磨材 (D)完成研磨須用高轉速
- 14 活動義齒包埋及沖蠟過後，下列何者錯誤？
(A)待石膏乾了後，趁著還熱的時候塗分離劑 (B)分離劑需塗佈整個石膏及樹脂牙表面
(C)待分離劑乾了後再塗第二層 (D)樹脂牙表面不能有蠟存在
- 15 下顎活動義齒後牙舌側面外型應呈現：
(A)稍微凹陷 (B)稍微突出
(C)顯著凹陷，使在樹脂牙下方形成倒凹外型 (D)顯著突出，以達到足夠厚度
- 16 有關重置位 (remounting) 全口義齒之咬合調整，下列敘述何者錯誤？
(A)達成平衡側接觸 (balancing contact)
(B)保存上下顎功能性咬頭 (functional cusp)
(C)修磨上下顎功能性咬頭 (functional cusp)
(D)當執行咬合調整時，應使門齒導柱 (incisal guide pin) 離開門齒機械導台 (incisal guidance table)，以便修磨後逐漸降低垂直距離
- 17 有關臨床重置位 (clinical remount)，下列何者錯誤？
(A)可先利用重置位架 (remounting jig) 及模型上的煮聚義齒製作一咬合性指標 (occlusal index)
(B)需重新取咬合記錄
(C)重置位模型 (remounting cast) 製作時，乃將義齒內部 (包括倒凹) 灌滿石膏
(D)也可以重新以面弓轉移，置位上顎模型
- 18 有關實驗室重置位 (laboratory remount)，下列何者錯誤？
(A)主要是為了去除義齒樹脂煮聚過程所造成之咬合誤差
(B)模型上的煮聚義齒重置位後，通常門齒導柱 (incisal guide pin) 會提高 1~2 mm
(C)為了方便模型重置位，模型底部可做裂模法 (split cast method)
(D)需重新取咬合記錄

- 19 關於義齒包埋與聚合的描述，下列何者錯誤？
(A)塗抹分離劑時要避開人工牙
(B)一階段濕式加熱聚合法會導致較明顯之聚合變形
(C)灌入法最大的優點是會減少咬合高度提高
(D)包埋材會因為使用的聚合材料與方法不同而改變
- 20 以下四個方法都可用來去除包埋盒中的蠟，請問那個方法最不會使蠟過度融化？
(A)60~70°C 水中浸泡 7~8 分鐘
(B)在沸水中浸泡 3 分鐘
(C)放置在沸騰的水蒸氣中 5 分鐘
(D)以微波爐 500 W 加熱 1 分鐘
- 21 關於義齒製作時使用聚合樹脂之描述，下列何者錯誤？
(A)使用微波聚合需使用特殊包埋盒
(B)微波聚合法屬加熱聚合法的一種
(C)一階段加熱聚合法的原則為高溫短時間
(D)常溫聚合樹脂在壓力下之聚合時間約 30 分鐘
- 22 請問以兩段式濕式加熱聚合法聚合義齒時，第一階段加熱的溫度與時間為下列何項？
(A)50~60°C，60~90 分鐘
(B)100°C，30~60 分鐘
(C)65~70°C，60~90 分鐘
(D)50~60°C，30~60 分鐘
- 23 請問以下那種包埋聚合方法所得到的義齒，其咬合高度改變最大？
(A)美式包埋
(B)法式包埋
(C)灌入法填入樹脂
(D)使用聚砜 (polysulfone) 樹脂
- 24 關於全口義齒人工牙排牙的敘述，下列何者錯誤？
(A)先排下顎或上顎會影響假想咬合平面的位置
(B)先排上顎後牙容易造成下顎之咬合平面往下降
(C)髁頭傾斜角較大者，建議用咬頭傾斜角較大的牙齒
(D)使用咬頭傾斜角較大的牙齒時，前牙能容許較大的垂直覆蓋
- 25 關於全口義齒齒肉形成之敘述，下列何者錯誤？
(A)不佳的齒肉形成有可能會影響義齒的穩定性
(B)頰側的齒肉要微凸以避免沾黏食物
(C)下顎舌側齒肉需略凹以承受舌壓
(D)腭部齒肉形成可能影響發音
- 26 關於全口義齒咬合模式的敘述，下列何者錯誤？
(A)偏舌側化咬合 (lingualized occlusion) 係強調將咬合力誘導至殘嵴的舌側以使義齒安定
(B)雙側平衡咬合無法以零度牙排列達成
(C)當上下顎間關係不佳時，有時交錯咬合排列 (crossbite) 有助義齒穩定
(D)偏舌側化咬合 (lingualized occlusion) 在白齒區的排列為 1 齒對 1 齒的方式排列
- 27 關於全口義齒前牙排列的敘述，下列何者錯誤？
(A)上下顎門齒排列以美觀為唯一考量
(B)門齒的材質不能比後牙耐磨
(C)上顎前面 6 顆門齒的寬度可以參考患者鼻翼的寬度來選擇
(D)前牙排列可以左右不對稱

- 28 在製作全口義齒的過程中，咬合基底與蠟堤無法取得下列何項資訊？
(A)何種咬合模式（occlusal scheme）最適合病人
(B)咬合平面
(C)咬合垂直高度
(D)顎間水平咬合關係
- 29 關於髁關節咬合器（arcon articulator）的敘述，下列何者正確？
(A)代表咬合器為半調節式
(B)常用的 Hanau H2 咬合器屬於這型
(C)咬合器的髁頭設計在咬合器的下半部
(D)不適用面弓轉移
- 30 在製作全口義齒咬合蠟堤進行咬合取得時，下列敘述何者不是製作蠟堤的原則？
(A)蠟堤的形狀與位置應儘量模擬未來義齒排列的狀態
(B)下顎蠟堤的高度一般與臼齒後墊（retromolar pad）的頂點等高
(C)上顎蠟堤不宜太長，一般設定停在上顎第一大臼齒部為止
(D)蠟堤的高度可能會依殘峭的吸收程度而改變
- 31 在製作全口義齒時，咬合取得的目的，不包括下列何者？
(A)記錄出患者的下顎靜止位置（rest position）
(B)記錄出患者上下顎的垂直關係
(C)記錄出患者上下顎的前後關係
(D)記錄出患者上下顎的左右關係
- 32 製作全口義齒個人牙托（individual tray）時，有關間隙劑（spacer）的敘述，下列何者錯誤？
(A)使用間隙劑的目的是在提供容納印模材的空間
(B)間隙劑厚度會因印模材使用的不同而有差異
(C)若不使用間隙劑會使印模無法進行
(D)石蠟（paraffin wax）可作為間隙劑使用
- 33 請問在製作全口活動義齒的過程中，下列步驟由開始到完成的順序排列為何？①建立工作用模型
②個人牙托製作 ③咬合器裝戴 ④咬合基底的製作 ⑤人工牙排列 ⑥人工牙齒針對病患特異之下顎運動進行磨修 ⑦包埋與聚合
(A)①②③④⑤⑥⑦ (B)②①③④⑤⑥⑦ (C)②①④③⑤⑦⑥ (D)②①④③⑤⑥⑦
- 34 製作全口義齒的步驟十分繁瑣，關於牙醫師與牙技師間合作的敘述，下列何者錯誤？
(A)製作順序會因不同醫師而不同
(B)一切只需被動依照技工指示書的指示進行即可
(C)需要時應雙向溝通
(D)前一步驟沒做好常會影響到下一步驟的進行
- 35 請問混雜義齒（hybrid denture）與下列何者同義？
(A)即裝義齒（immediate denture）
(B)暫用義齒（interim denture）
(C)覆蓋式義齒（overdenture）
(D)閉孔器（obturator）
- 36 以下何種前牙組合，會形成最大的矢狀面門齒導引角？
(A)大的水平覆蓋（overjet），大的垂直覆蓋（overbite）
(B)大的水平覆蓋（overjet），小的垂直覆蓋（overbite）
(C)小的水平覆蓋（overjet），小的垂直覆蓋（overbite）
(D)小的水平覆蓋（overjet），大的垂直覆蓋（overbite）

- 37 以下何者不屬於常用在咬合器上之基準平面？
(A)Bonwill 平面 (B)咬合平面
(C)甘伯氏 (Camper's) 平面 (D)法蘭克福 (Frankfort) 平面
- 38 患者上顎因病部分切除後，以活動義齒膺復失去的牙齒與上顎組織，這種活動義齒稱爲什麼？
(A)即裝義齒 (immediate denture) (B)暫用義齒 (interim denture)
(C)覆蓋式義齒 (overdenture) (D)閉孔器 (obturator)
- 39 將牙根或植體覆蓋在義齒基底底下以便分散力量的義齒稱爲：
(A)即裝義齒 (immediate denture) (B)暫用義齒 (interim denture)
(C)覆蓋式義齒 (overdenture) (D)閉孔器 (obturator)
- 40 牙齒拔除後立刻給予的全口或部分活動義齒稱爲：
(A)即裝義齒 (immediate denture) (B)暫用義齒 (interim denture)
(C)覆蓋式義齒 (overdenture) (D)閉孔器 (obturator)
- 41 欲進行活動局部義齒人工牙齒排列時，若量測患者之水平向髁徑傾斜角度 (horizontal condylar angle) 爲 25 度，則此時側向髁徑傾斜角度應調整爲多少角度？
(A)10 度 (B)15 度 (C)20 度 (D)25 度
- 42 在牙鉤 (clasp) 組成結構中，有關固位鉤臂 (retentive arm) 具備之性質，下列敘述何者錯誤？
(A)牙鉤臂厚度愈大，固位作用愈大
(B)牙鉤臂愈長，固位作用愈大
(C)使用彈性模數 (modulus of elasticity) 愈大之合金，固位作用愈大
(D)設計的倒凹量 (undercut) 愈大，固位作用愈大
- 43 下列何者組織位置可以作爲上顎主要垂直咬合力量的承受區 (stress bearing area)？
(A)皺摺區 (rugae area) (B)門齒乳頭 (incisive papilla)
(C)軟組織 (soft tissue) (D)齒槽骨嵴頂 (alveolar ridge crest)
- 44 若咬合面鉤靠座 (occlusal rest seat) 與支柱牙鄰接表面所形成之角度設計不良時，易造成支柱牙之位移與傷害，此現象是由下列何種效應所導致？
(A)槓桿 (lever) (B)輪軸 (axle)
(C)斜面 (inclined plane) (D)螺旋 (screw)
- 45 在亞克斯牙鉤 (Akers clasp) 組成結構中，下列何種結構需具備剛硬性 (rigidity)？①鉤靠 (rest) ②牙鉤之肩部 (shoulder) ③固位性鉤臂 (retentive arm) ④抗衡性鉤臂 (reciprocal arm)
(A)①②③ (B)②③④ (C)①③④ (D)①②④
- 46 活動局部義齒組成結構中，下列何者無法作爲抗衡性元件 (reciprocal element) 以提供適當的抗衡作用？
(A)牙鉤 (clasp) (B)小連接體 (minor connector)
(C)舌側板 (lingual plate) (D)假牙基底 (denture base)
- 47 於製作活動局部義齒過程中，利用瓊膠 (agar) 進行模型複製時，需先將主模型浸置於下列何種飽和溶液中，以防止模型產生溶解現象？
(A)硫酸鈉 (B)硫酸鈣 (C)碳酸鈉 (D)碳酸鈣

- 48 當樹脂材料其聚合體 (polymer) 與單體 (monomer) 充分混合反應過程中，需於下列那一作用時期進行樹脂之填充 (packing) 最為適當？
(A)膠狀期 (rubbery stage) (B)黏性期 (sticky stage)
(C)糰狀期 (dough stage) (D)砂狀期 (sandy stage)
- 49 設計與製作活動局部義齒時，欲利用鉻合金或鈦合金製作固位性牙鉤 (retentive clasp) 時，宜採用下列何種倒凹量器 (undercut gauge) 最為適當？
(A)0.01 mm (B)0.01 cm (C)0.01 inch (D)0.01 m
- 50 操作析量器 (surveyor) 時，對主模型傾斜方向之敘述，下列何者錯誤？
(A)以操作者由模型後部之觀點為基準 (B)以操作者由模型前方之觀點為基準
(C)若主模型的前半部較低，稱之為前傾 (D)主模型右半部較低時，稱為右傾
- 51 製作活動局部義齒過程中，當進行封凹 (blockout) 與緩壓 (relief) 時，下列那一步驟需正確地使用析量器 (surveyor) 來執行？
(A)任意式封凹 (arbitrary blockout) (B)形態式封凹 (shaped blockout)
(C)平行式封凹 (paralleled blockout) (D)緩壓
- 52 利用藻膠 (alginate) 印模並完成灌注石膏模型後，至少需靜置多少時間後才可將印模與石膏模型分離？
(A)45~60 分鐘 (B)90~100 分鐘 (C)120~130 分鐘 (D)180~190 分鐘
- 53 下列何種主連接體 (major connector) 之設計，其剛硬性 (rigidity) 最差，易發生變形現象？
(A)前後腭帶 (anteroposterior palatal strap) (B)全腭板 (complete palatal plate)
(C)馬蹄形腭帶 (horseshoe connector) (D)腭槓 (palatal bar)
- 54 製作活動局部義齒時，若分別選用樹脂基底或金屬基底作為義齒基底之設計，下列敘述何者錯誤？
(A)金屬導熱性優於樹脂 (B)金屬清潔性優於樹脂
(C)樹脂較金屬美觀 (D)樹脂之精密度優於金屬
- 55 在活動局部義齒設計中，對於甘迺迪第四類缺牙之患者，將無法採用下列何種型式之主連接體 (major connector)？①馬蹄形腭帶 (horseshoe connector) ②腭帶 (palatal strap) ③全腭板 (complete palatal plate) ④腭槓 (palatal bar)
(A)①② (B)①③ (C)①④ (D)②④
- 56 製作活動局部義齒時，若主連接體 (major connector) 採用舌側槓 (lingual bar) 之設計，應使用幾號蠟片進行緩壓 (relief) 處理最為適當？
(A)22 號 (B)26 號 (C)32 號 (D)18 號
- 57 在活動局部義齒中，其金屬支架上附著樹脂基底區域與主模型間應選用下列何種蠟片進行緩壓 (relief) 處理最為適宜？
(A)20 號 (B)26 號 (C)28 號 (D)30 號
- 58 完成人工義齒排列及齒肉形成後，欲進行分模式包埋 (split-mold investing) 步驟且需保持工作模型之完整性，則活動局部義齒需包幾層？並從那一層中分離進行填充樹脂？
(A)包三層；從第一、二層中間分離 (B)包三層；從第二、三層中間分離
(C)包四層；從第二、三層中間分離 (D)包四層；從第三、四層中間分離

- 59 製作活動局部義齒，當進行盒埋（flasking）時，此工作模型與包埋盒（flask）頂端之間至少需保留多少距離，才能維持足夠之強度？
(A)8 mm (B)10 mm (C)13 mm (D)15 mm
- 60 當活動局部義齒之小連接體（minor connector）斷裂後，利用電銲法（electric solder）進行修復時，下列敘述何者錯誤？
(A)可局部加熱，不易影響假牙樹脂基底
(B)具有銅極與碳極，碳極尖端需放置於銲接處之銲金上
(C)具有銅極與碳極，銅極尖端需放置於銲接處之銲金上
(D)電銲法較火焰銲接法（torch solder）易於操作
- 61 有關活動局部義齒之工作指示書（work authorizations）記載的內容應具備之性質，下列敘述何者錯誤？
(A)為牙醫師對牙體技術所要求服務的書面資料
(B)需詳細記載製作材料與時間
(C)對甘迺迪第一、二類缺牙需繪製設計圖，其餘則否
(D)可作為訴訟的合法證明文件
- 62 若採用通用號碼系統，上顎殘存的牙齒為#5，#6，#11，#12 時，屬於甘迺迪（Kennedy）分類系統的那一類？
(A)class I (B)class I mod. 1 (C)class IV (D)class IV mod. 1
- 63 在甘迺迪（Kennedy）分類法中，那一類型分類沒有變形區（modification）？
(A)class I (B)class II (C)class III (D)class IV
- 64 上顎主連接體（major connector）邊緣製作珠狀緣飾（bead line）時，其最理想深度為何？
(A)0.1 mm (B)0.5 mm (C)1.5 mm (D)2 mm
- 65 當上顎僅殘留六顆前牙，且缺牙區之齒槽嵴較低時，下列何種主連接體為最適當之設計？
(A)舌側板（lingual plate） (B)前後腭帶（anteroposterior palatal strap）
(C)全腭板（complete palatal plate） (D)馬蹄形腭帶（horseshoe connector）
- 66 製作下顎 class I 活動局部義齒時，為防止樹脂填塞過程中造成金屬支架發生彎曲變形，應於基底金屬支架的游離端（free end）處作何種設計？
(A)鉤靠（rest） (B)完成線（finishing line）
(C)珠狀緣飾（bead line） (D)組織止點（tissue stop）
- 67 由左側眼眶下緣（orbitale）與兩側耳珠（tragus）或外耳道所形成的假想平面為：
(A)法蘭克福平面（Frankfort plane） (B)蒙他各氏平面（Montague's plane）
(C)甘伯氏平面（Camper's plane） (D)布洛克氏平面（Broca's plane）
- 68 下列何者是造成樹脂基底產生多孔性的主要原因？
(A)去蠟時間過久 (B)樹脂填充（packing）壓力過大
(C)沒有塗佈分離劑 (D)樹脂煮聚溫度過高

- 69 金屬支架上的內部完成線（internal finishing line）應與義齒基底樹脂（denture base resin）呈何種角度相接？
(A)小於 90 度 (B)大於 90 度 (C)等於 90 度 (D)大於 180 度
- 70 在診斷模型上設計時，金屬支架的設計最常使用何種顏色之鉛筆畫出其外形線？
(A)棕色 (B)藍色 (C)紅色 (D)黑色
- 71 下顎設計舌側槓（lingual bar）之主連接體時，其橫切面應製作呈什麼形狀？
(A)半圓型 (B)圓型 (C)三角型 (D)半梨型
- 72 當活動局部義齒完成義齒排列及基底蠟型製作，並進行盒埋（flasking）與去蠟後，下列那一組成會出現在包埋盒（flask）之上半部？
(A)人工義齒 (B)金屬支架 (C)牙鉤 (D)工作模型
- 73 製作活動局部義齒支架過程中，以支柱牙之鄰接面作為引導面（guiding plane）時需進行下列何種步驟？
(A)緩壓（relief） (B)任意式封凹（arbitrary blockout）
(C)形態式封凹（shaped blockout） (D)平行式封凹（paralleled blockout）
- 74 活動局部義齒最常使用的鍛製金屬線（wrought wire）大小為何？
(A)30~32 gauge (B)24~26 gauge (C)17~20 gauge (D)12~15 gauge
- 75 有關活動局部義齒進行修補（repair）處理之方式，下列敘述何者錯誤？
(A)鑄造咬合鉤靠（rest）斷裂可利用樹脂修補
(B)固位牙鉤臂（retentive clasp arm）斷裂可利用鍛製金屬線（wrought wire）修補
(C)某些主連接體（major connector）斷裂可利用電鍍法（electric solder）修補
(D)義齒樹脂基底變色可利用換底（rebase）方式修補
- 76 支柱牙之倒凹量（undercut）其最大容許度量為何？
(A)0.03 mm (B)0.02 mm (C)0.02 inch (D)0.03 inch
- 77 甘迺迪分類系統（Kennedy classification system）其分類之主要準則是依據下列何者？
(A)固位體設計之位置 (B)牙弓上殘存自然齒之位置
(C)臼齒咀嚼機能區之位置 (D)牙弓上缺牙區之位置
- 78 活動局部義齒完成盒埋（flasking），於進行去蠟過程中，應先將包埋盒（flask）置於沸水中作用多少時間最為適宜？
(A)20 分鐘 (B)15 分鐘 (C)10 分鐘 (D)5 分鐘
- 79 製作內部完成線（internal finishing line）時，應距離支柱牙鄰接面至少需維持多少距離？
(A)0.5 mm (B)1 mm (C)1.5 mm (D)2 mm
- 80 熱聚式樹脂（heat-curing resin）進行加熱聚合反應時，欲使樹脂具有適當的強度及減少孔洞的形成，下列那一種聚合條件最不適宜？
(A)74°C 維持 7 小時，再加熱至 100°C 維持 30 分鐘
(B)165°C 維持 2 小時，再加熱至沸騰維持 30 分鐘
(C)74°C 維持 1.5 小時，再加熱至 100°C 維持 30 分鐘
(D)165°F 維持 9 小時